

2007年3月期 決算説明会



新日本無線株式會社

2007年5月11日

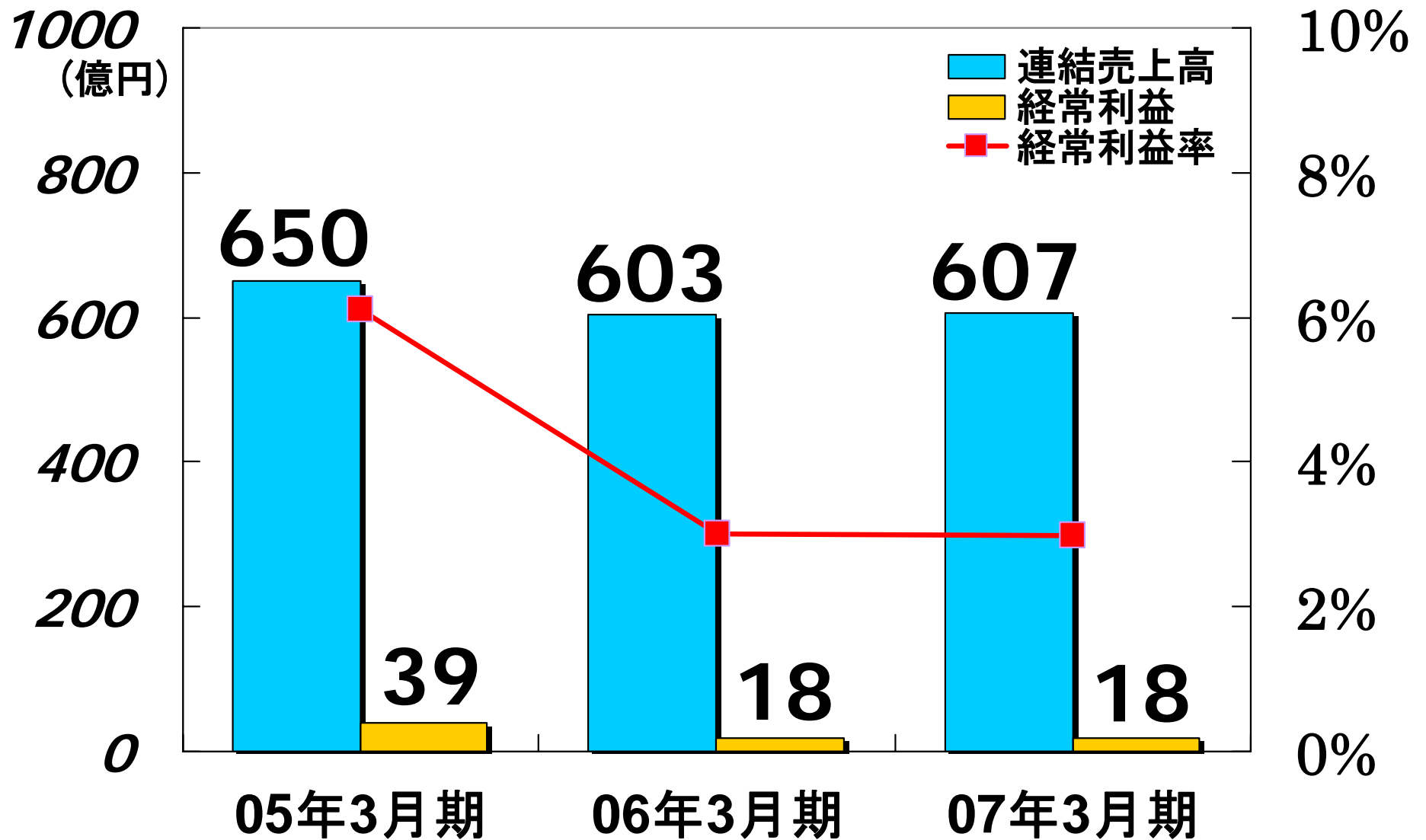
07年3月期 損益計算書(連結)

[単位：百万円]

	06年3月期	07年3月期	前年度比	
			金額	増減率
売上高	60,332	60,725	392	0.7 %
売上原価	47,243	47,295	52	
販売費及び一般管理費	11,334	11,590	255	
営業利益	1,754	1,839	84	4.8 %
営業外収益	212	222	10	
営業外費用	155	254	99	
経常利益	1,811	1,807	△ 4	△ 0.2 %
特別損益	△ 70	933	1,004	
税金等調整前当期純利益	1,740	2,740	999	57.4 %
法人税,住民税及び事業税等	622	1,018	396	
当期純利益	1,118	1,721	603	54.0 %

連結売上高と利益の推移

売上高経常利益率



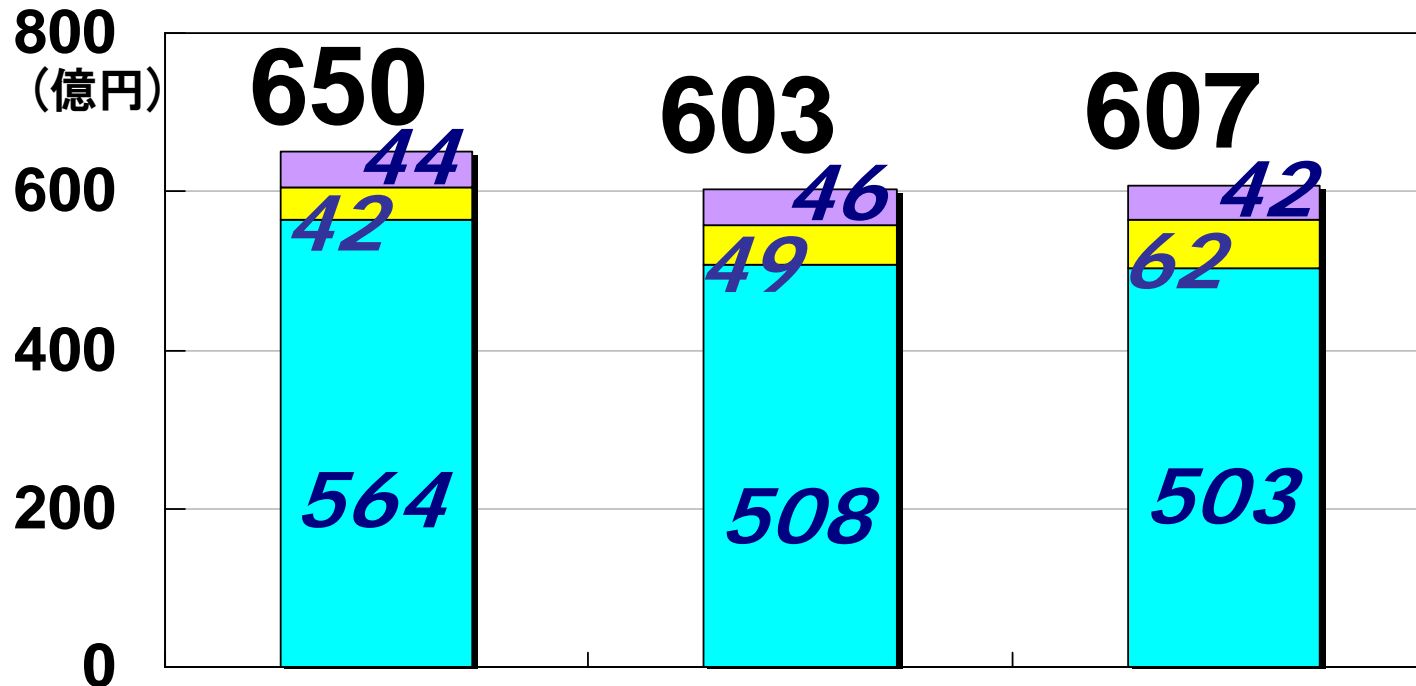
07年3月期 決算トピックス

(連結売上高前年度比)

◆半導体部門 前年度並 →			
バイ ポーラ	オペアンプ・コンパレータ	前年度並 →	△0.8%
	電源用IC	好調 ↗	+ 8.5%
	モータ用IC	好調 ↗	+ 33.2%
	オーディオ用・ビデオ用IC	低調 ↘	△17.6%
モス	水晶発振器用IC	好調 ↗	+ 22.8%
	DSP	低調 ↘	△31.6%
	LCDドライバ	低調 ↘	△16.8%
半導体デバイス		好調 ↗	+ 14.7%
受託生産品(NJR福岡)		好調 ↗	+ 3.1%
◆マイクロ波応用製品部門 好調 ↗			
衛星通信用コンポーネント製品		好調 ↗	+ 28.1%

07年3月期 事業部門別売上高(連結)

■ マイクロ波管
■ マイクロ波応用
■ 半導体



[単位：億円]	05年3月期	06年3月期	07年3月期
マイクロ波管	44	46	42
マイクロ波応用	42	49	62
半導体	564	508	503
合計	650	603	607

07年3月期 設備投資等(連結)

[単位：百万円]

	06年 3月期	07年 3月期	前年度比	
			金額	増減率
設備投資	2,714	3,477	763	28.1%
減価償却費 (有形・無形)	4,285	3,885	△400	△9.4%
研究開発費	6,304	6,182	△121	△1.9%

07年3月期 貸借対照表(連結)

[単位：百万円]

	06年3月期	07年3月期	増 減
資産合計	58,912	60,361	1,449
流動資産	36,422	37,913	1,490
現金/預金	4,627	6,577	1,949
受取手形/売掛金	15,502	15,258	△ 243
たな卸資産	14,914	14,816	△ 97
その他	1,377	1,260	△ 117
固定資産	22,490	22,448	△ 41
有形固定資産	15,739	15,615	△ 124
無形固定資産	244	318	74
投資他の資産	6,506	6,514	8

07年3月期 貸借対照表(連結)

[単位：百万円]

	06年3月期	07年3月期	増 減
負債及び純資産合計	58,912	60,361	1,449
負債合計	34,578	34,376	△ 202
流動負債	24,378	24,687	309
支払手形/買掛金	8,345	9,435	1,089
短期借入金	9,677	8,077	△ 1,600
1年内返済予定の長借金	210	185	△ 24
その他	6,144	6,989	844
固定負債	10,199	9,688	△ 511
長期借入金	441	274	△ 166
退職給付引当金	9,238	8,840	△ 398
その他	520	573	52
純資産(資本)合計	24,333	25,985	1,651

08年3月期 事業計画前提条件

連結 07年3月期売上実績:607億円→ 08年3月期売上計画:630億円(3.7%増)

マイクロ波関係		対前年比
マイクロ波管	官需回復、民需増	6.6%増
マイクロ波応用	衛星通信用コンポーネント製品売上減少 (従来の水準へ)	16.3%減

半 導 体		対前年比
全 体	既存製品の深耕と新製品売上比率向上	6.0%増
半導体デバイス	GaAs IC新規採用計画、 光半導体デバイス製品販売増	21.3%増
バイポーラ	電源用IC、オーディオ用/ビデオ用IC販売増	2.0%増
モ ス	DSP、電源用IC、LCDドライバ販売増	14.5%増

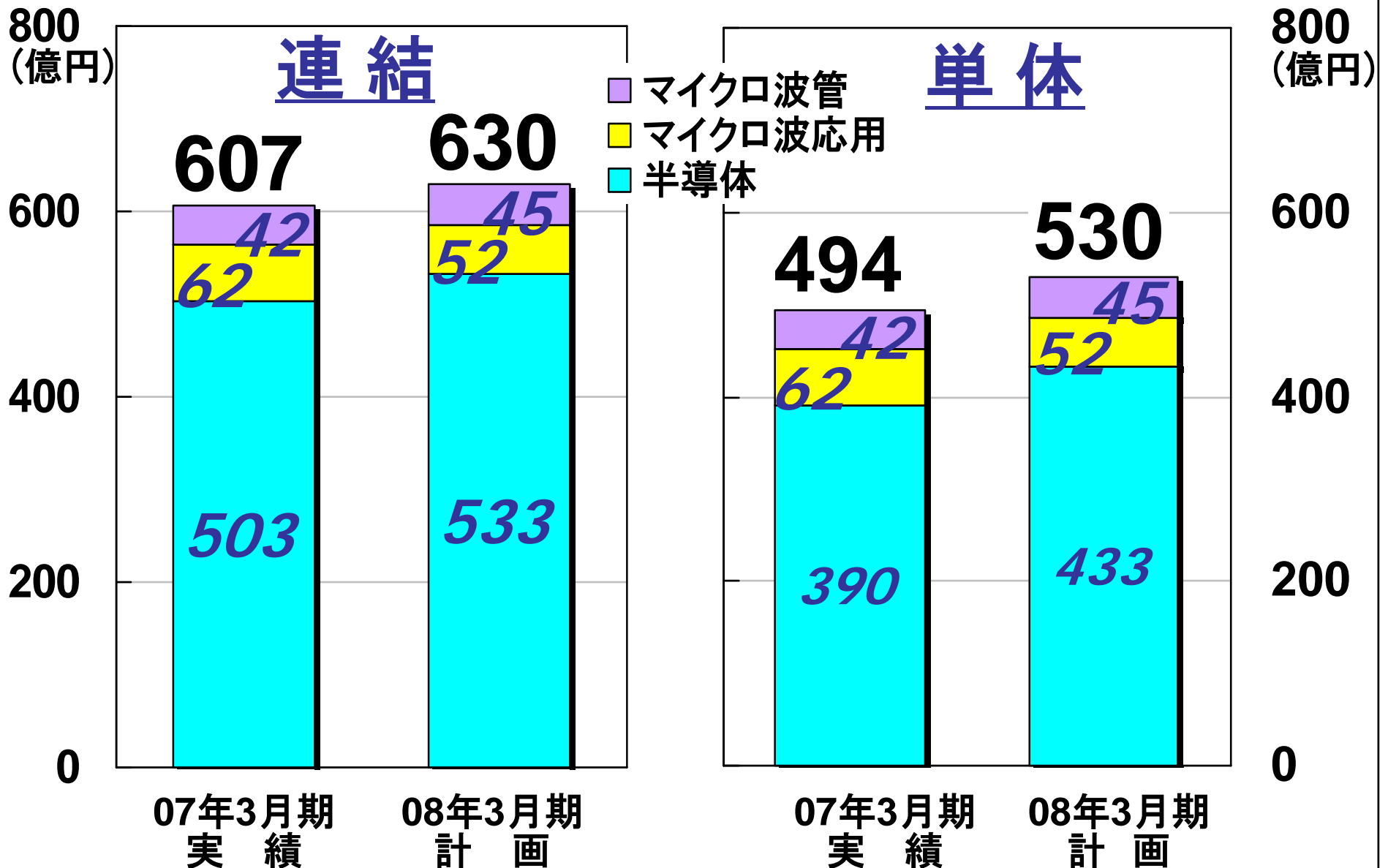
計画為替レート	¥115.00 / US\$
---------	----------------

08年3月期 事業計画(連結)

[単位：百万円]

	07年3月期 実績	08年3月期 計画	対前年比	
			金額	増減率
売上高	60,725	63,000	2,274	3.7 %
売上原価	47,295	49,200	1,904	
販売費及び一般管理費	11,590	11,800	209	
営業利益	1,839	2,000	160	8.8 %
営業外収益	222	140	△ 82	
営業外費用	254	140	△ 114	
経常利益	1,807	2,000	192	10.7 %
特別損益	933	△ 100	△ 1,033	
税金等調整前当期純利益	2,740	1,900	△ 840	△ 30.7 %
法人税,住民税及び事業税等	1,018	700	△ 318	
当期純利益	1,721	1,200	△ 521	△ 30.3 %

08年3月期 事業部門別売上計画



08年3月期 事業部門別売上比率

〈計画〉

〈売上高〉	連 結		単 体	
マイクロ波管	45 億円	7.1%	45 億円	8.5%
マイクロ波応用	52 億円	8.3%	52 億円	9.8%
半 導 体	533 億円	84.6%	433 億円	81.7%
合 計	630 億円	100.0%	530 億円	100.0%

〈連結〉

マイクロ波管

7.1%

マイクロ波応用

8.3%

半導体
84.6%

7.2% 半導体デバイス

58.7% バイポーラ

18.7% モス

08年3月期 設備投資等計画(連結)

[単位：百万円]

	07年3月期 実績	08年3月期 計画	対前年比	
			金額	増減率
設備投資	3,477	4,690	1,212	34.9%
減価償却費 (有形・無形)	3,885	5,083	1,197	30.8%
研究開発費	6,182	6,665	482	7.8%

製品展開（マイクロ波製品）

マイクロ波管

マイクロ波電子管

船舶レーダ用マグネトロン→次期スプリアス規制対応（不要輻射抑制）

カソード及び電子銃

マイクロ波応用製品

衛星通信コンポーネント製品
（送受信ユニット）

VSAT用ODU（アトミアユニット）の
ラインナップ強化

- * 小型/省電力化
- * 高出力/高効率化
- * 送受信一体化

地上通信コンポーネント製品
（送受信ユニット）























WIPAS用ODUの欧州規格
への対応/製品化

地上波デジタル放送中継器用
RFユニットのシリーズ化

センサモジュール

産業用/車載用
測距モジュールの
製品化

事業展開（半導体製品）

主要製品群/市場	AV	通信	PC	産機	車載	その他
モス表示関連 → LCD、VFD、白色LED、RGBドライバ						
モータ → FANモータ、ステッピングモータ						
汎用品 → オペアンプ、電源、水晶発振						
オーディオ → アンプ、AP、DSP、電子ボリューム						
ビデオ → 高性能ビデオアンプ、TFT信号処理						
通信 → GaAsIC、通信用IC						
重点市場 今後の展開	DSP・新製品拡充 アナログオーディオ・ビデオ分野の維持	無線通信用IC拡充 GaAsIC製品拡充	モータ用・汎用IC拡充 AV市場向け製品から波及	高性能汎用ICの拡充 モータ用ICの拡充・販売分野拡大	車載市場への対応強化と販売拡大	アミューズメント市場への販売拡大

バイポーラ
化合物
Bi-MOS
〔当社保有〕
プロセス

製品展開（半導体製品）

バイポーラ・モスIC

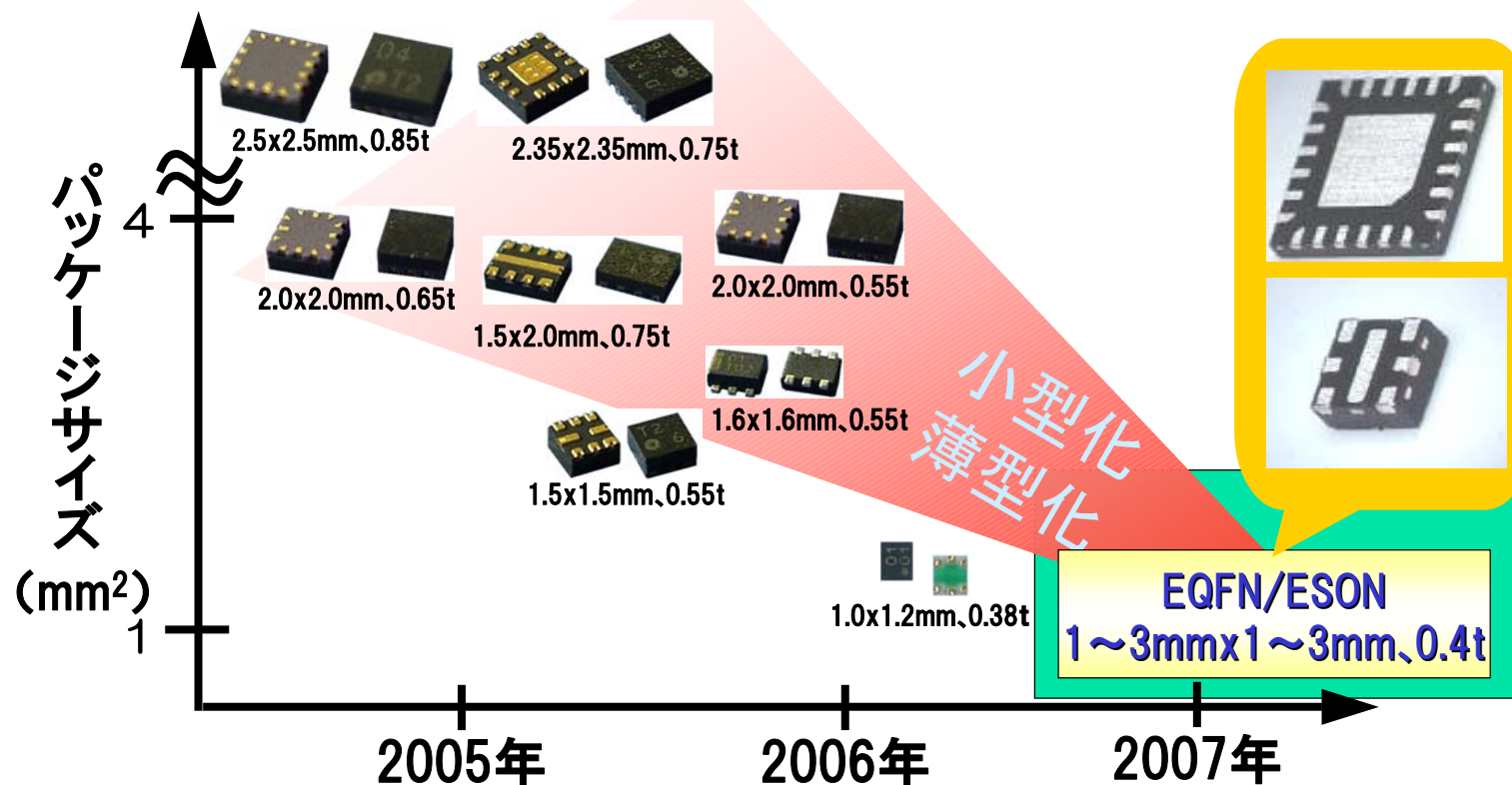
オペアンプ	電源用 IC	モータ用 IC
入出力フルスイング、 低消費電力 (デジタル機器、産業機器)、 超高速、高精度、ローノイズ (産業機器)	LDO／ボルテージディテクタ、 スイッチングレギュレータ、 充電制御用(リチウムイオン電池)、 低電圧動作、大電流対応、 アプリケーション別複合化電源	高出力化、高耐圧化 (ファンモータ用、 ステッピングモータ用)
表示関連	オーディオ用／ビデオ用 IC	水晶発振器用 IC
LCDドライバ、 B&W LCD用(カーオーディオ)、 VFDドライバ(A/V機器)、 白色及びRGB LEDドライバ	ビデオアンプ(車載カメラ、カーナビ等)、 電子ボリューム(薄型TV、カーオーディオ、AVアンプ)、D級アンプ、DSP(薄型TV、カーオーディオ)	低電圧動作、 低消費電流、 高周波対応 (光通信、デジタル機器)

半導体デバイス

GaAs IC		光半導体デバイス
製品内容: LNA、ミキサ、受信系複合IC、 アンテナSW、各種スイッチ、 パワーアンプ、ドライバアンプ、 高集積高周波IC	用途: 携帯電話向け高周波IC (W-CDMA、CDMA2000、GSM、 PHS)、 その他用途向け高周波IC (無線LAN、Bluetooth、GPS等)	超小型センサCOBPIリフレクタ (携帯電話用レンズモジュール)、 リモコン受光モジュール(A/V機 器等)、光ピックアップ用PD、 PDIC(DVD)、照度センサ

パッケージ展開（半導体製品）

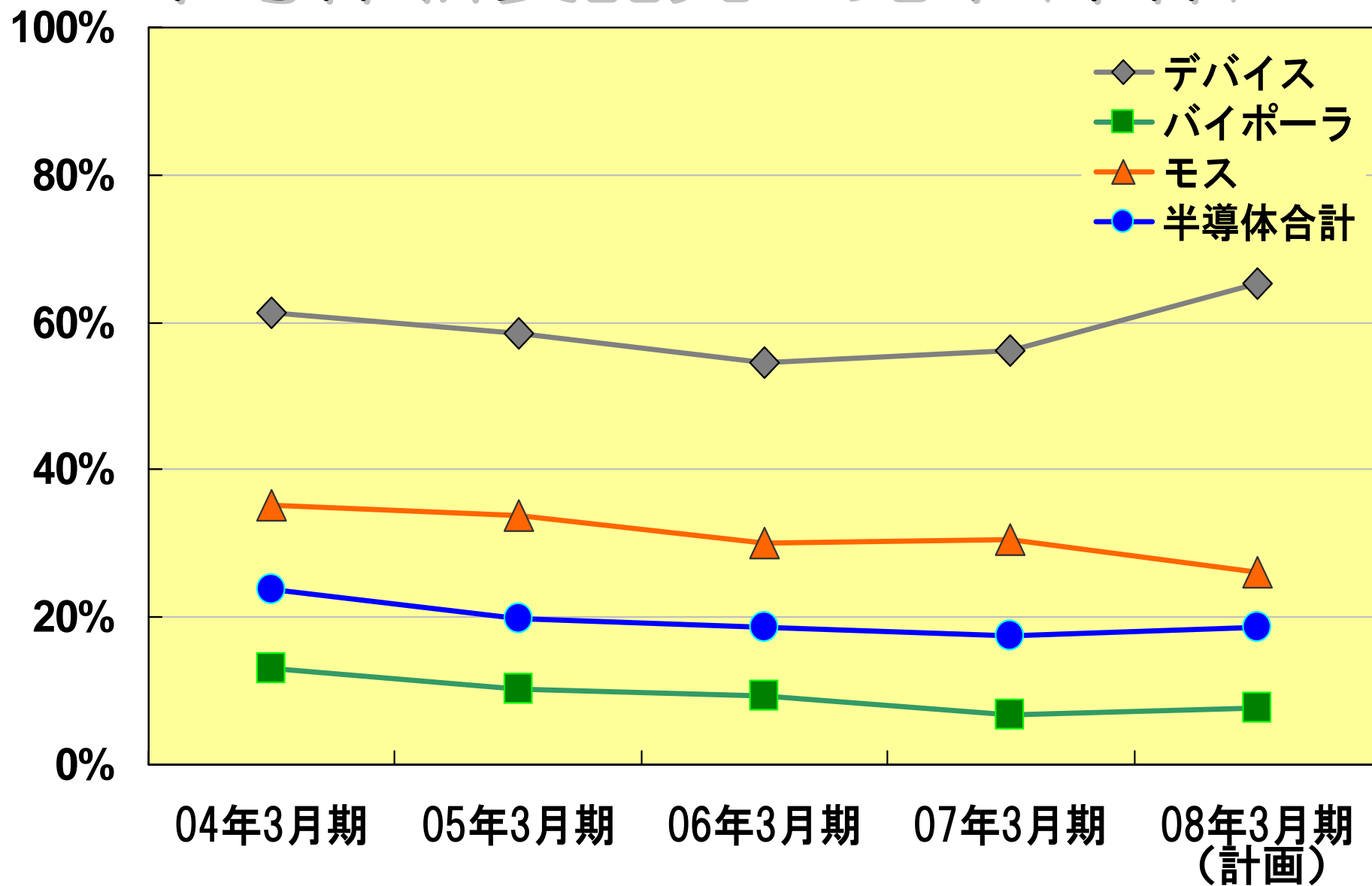
◆小型化・薄型化のロードマップ



◆汎用CSP(チップサイズパッケージ)への注力

- ・搭載機器の小型軽量化・多機能化に対応
- ・生産ラインの集約による効率化を目指す

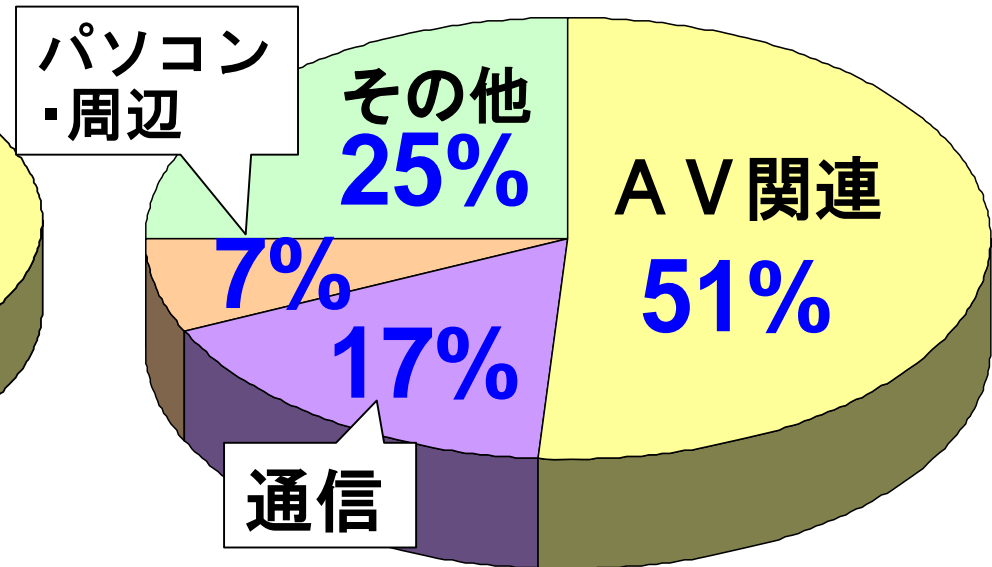
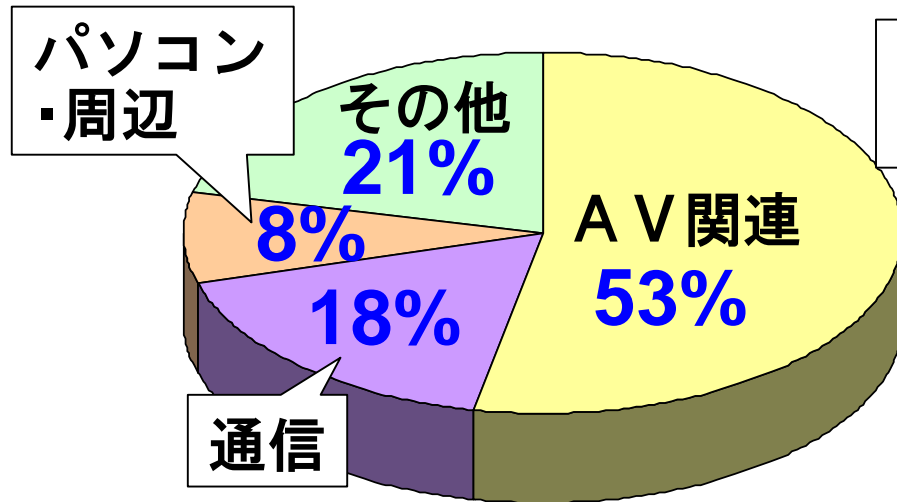
半導体新製品売上比率(単体)



半導体販売分野別状況

06年3月期

07年3月期



経営戦略～中期展望～

営業力の強化と拡充

- 顧客近接の設計拠点
大阪・SINGAPOREのデザインセンター活用
- 中国上海地区の営業支援拠点活用

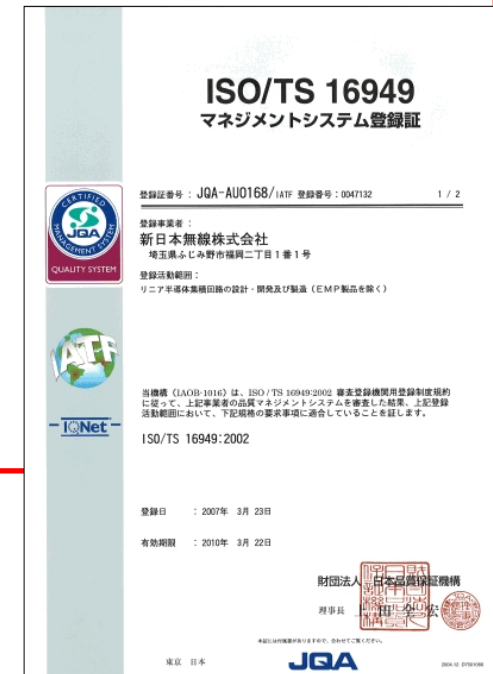
競争力ある新製品の開発

- 長期視野に立った新規ビジネス分野の探索
→車載用、産業機器、通信等

注力分野(車載用)

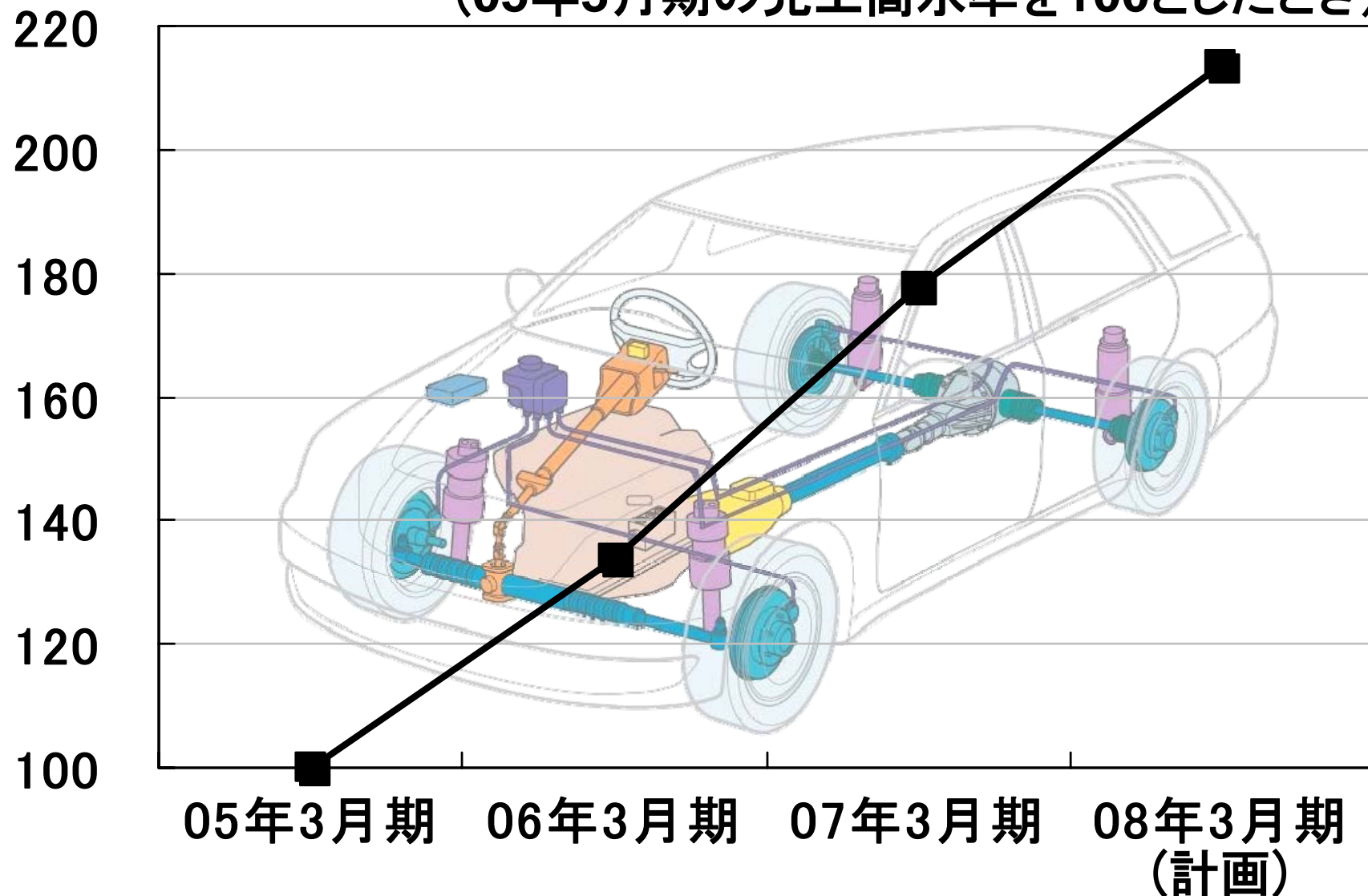
カーナビ、カーオーディオ等アクセサリ向け製品に加え
自動車制御装置や安全機器向け製品に注力

- ・ISO/TS16949認証取得(2007年3月24日)
(自動車産業向け品質マネジメントシステム)
- ・国内自動車メーカーよりオペアンプ・コンパレータの
コア・メーカーとして認定
- ・ $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$ の動作・特性保証
(エンジンルーム内でも使用可能)
- ・Made in Japan (国内生産ラインに限定)
高品質作り込み・迅速な対応を徹底



車載品の成長性

(05年3月期の売上高水準を100としたとき)



新規応用分野への取組(産業機器向け)

高精度オペアンプ

高温や高ノイズ下でも安定した精度を保持

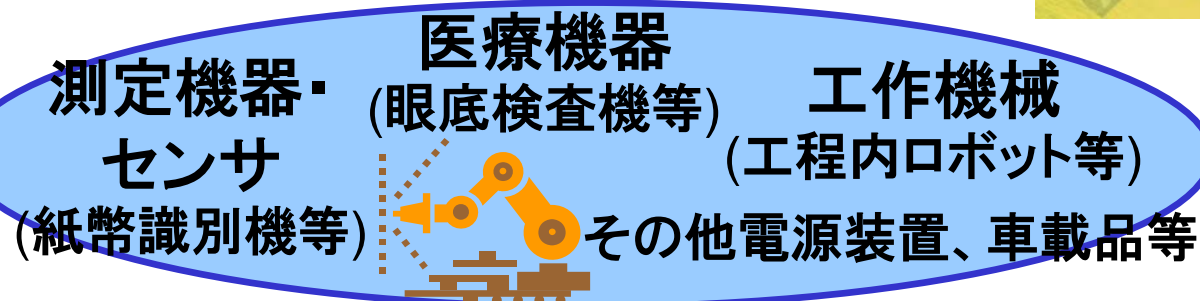
高耐圧・高速オペアンプ

高電圧下でも高速な動作が求められる



<ねらい>

・広い応用分野



・高付加価値

・価格競争力と高性能の両立→高利益率

・継続的販売

・セット品のライフサイクルが長い→継続的販売



08年3月期 下期から本格的な売上・利益貢献を期す
継続的な売上・利益の軸に

経営戦略～中期展望～

成長・モノづくり基礎体力の強化

半導体事業の統括機能強化

THAI NJR・NJR福岡の活用

品質経営、環境経営の実践

内部統制システム
リスクマネジメントシステムの構築・定着化

事業部門別状況

マイクロ波管

レーダ用部品が主体 マグネトロン、
TWT、CFA、レーダコンポーネント

官需用は国内3社に限定

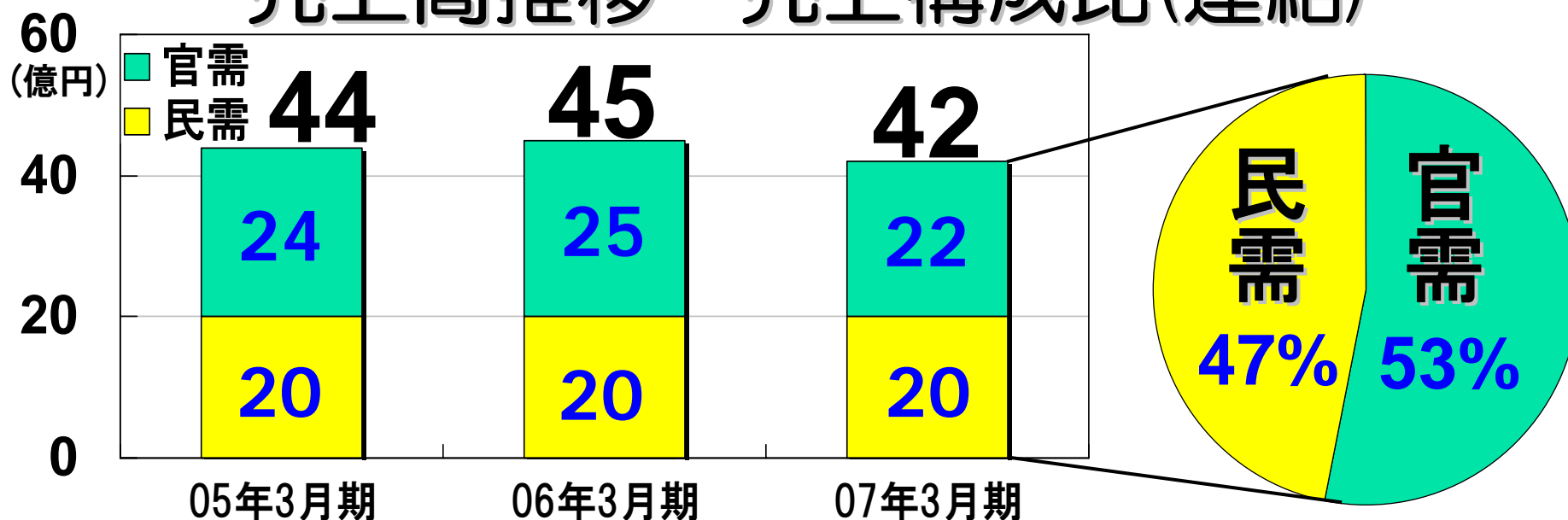
民需用は国内1社、海外1社で寡占

(当社シェア 70%)



M1555

売上高推移・売上構成比(連結)



2007年5月11日

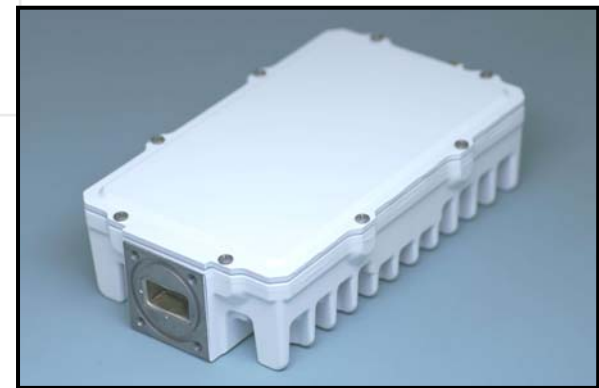
新日本無線株2007年3月期 決算説明会

24

事業部門別状況

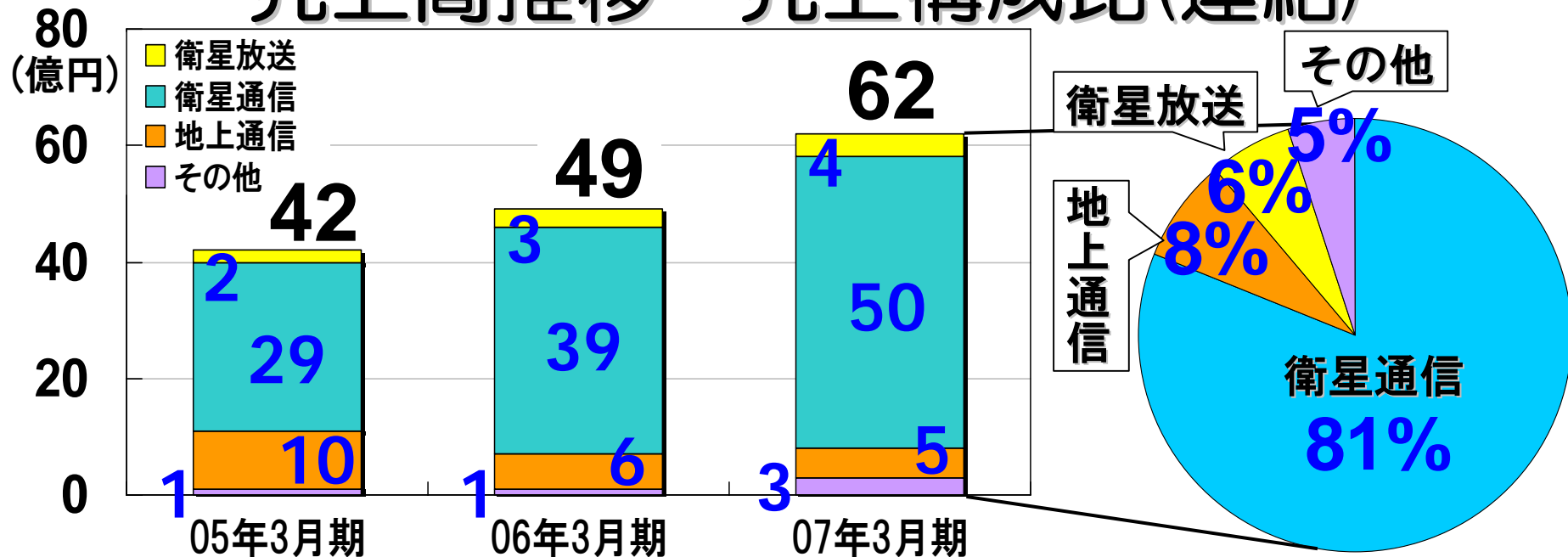
マイクロ波応用製品

衛星放送／衛星通信用及び地上通信用
送受信コンポーネント製品が主体
トランスミッタ、レシーバ、トランシーバ



NJT5034F

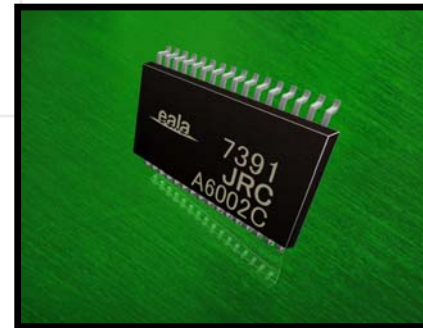
売上高推移・売上構成比(連結)



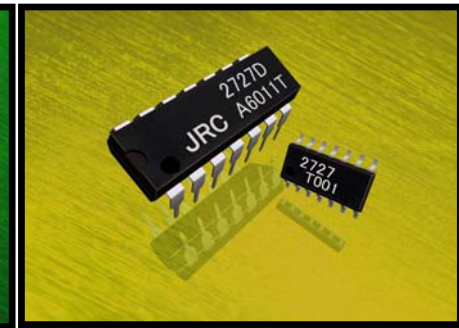
事業部門別状況

半導体

アナログ系汎用品が主体
オペアンプ／コンパレータ、
電源IC、
オーディオ・ビデオ用IC

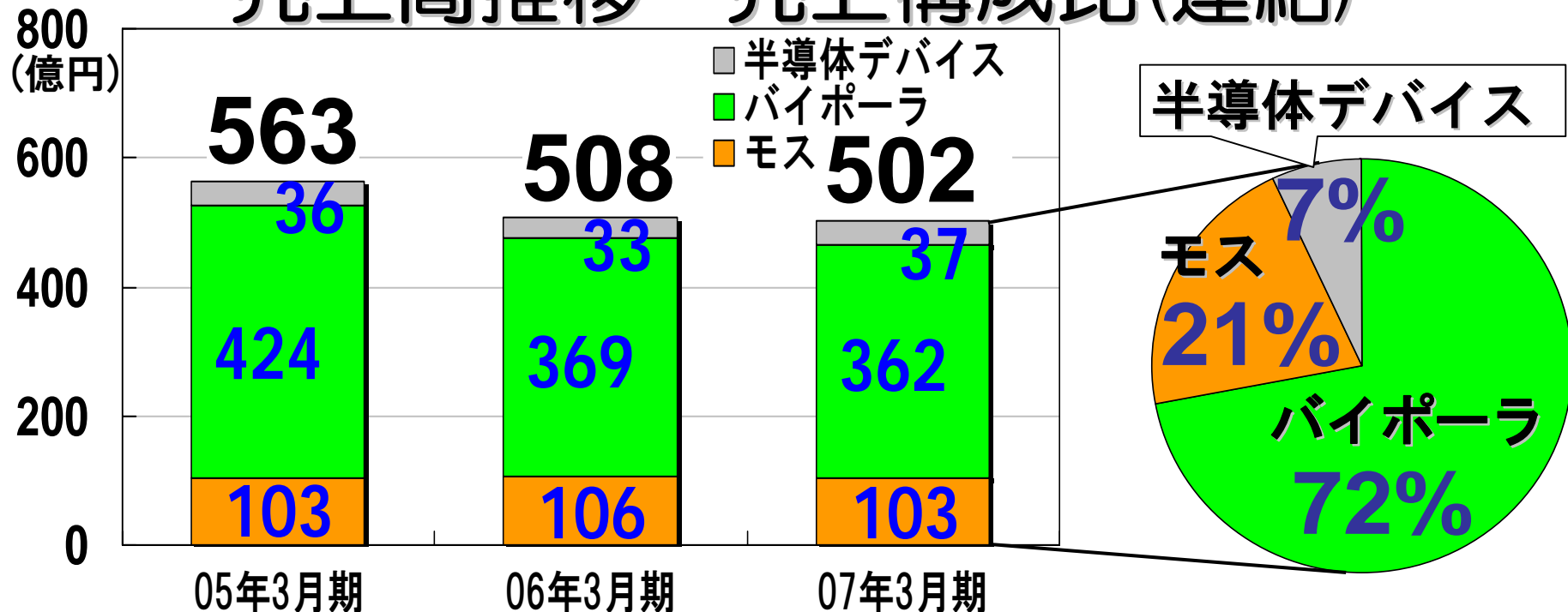


NJU7391



NJM2727

売上高推移・売上構成比(連結)



会社概要

創 立	1959年(昭和34年) 9月	
	日本無線(株)より半導体、マイクロ波技術を継承。量産部品メーカーとして創立。以降、両技術を発展・応用させ規模拡大。	
沿 革	1991年11月	株式公開
	2000年10月	東証第 2 部上場
	2002年 9月	東証第 1 部上場
	2005年12月	親会社の異動 旧：日本無線(株) 新：日清紡績(株)
資 本 金	52億円 (日清紡績(株)出資比率 59.6%)	
従業員数	連結 3,198名	
グループ会社(連結子会社)	半導体製造会社(前工程) 福岡の1社	
	半導体製造会社(後工程) 佐賀・タイ・秩父の3社	
	半導体販売会社 国内・シンガポール・米国の3社	
	業務受託会社 国内の1社	
売 上 高	2007年3月期	495 億円 (連結 607億円)
	2006年3月期	482 億円 (連結 603億円)

新日本無線株式会社

本社
東京都中央区



本社機構・半導体営業部門

川越製作所
埼玉県ふじみ野市



半導体製造前工程・研究開発部門
マイクロ波管部門
マイクロ波応用製品部門

グループ会社

販売子会社

(国内) (株)エヌ・ジェイ・アールトレーディング

(海外) NJR CORPORATION

NJR (SINGAPORE) PTE LTD

生産子会社

(国内) 佐賀エレクトロニクス(株)

(株)エヌ・ジェイ・アール秩父

(株)エヌ・ジェイ・アール福岡

(海外) THAI NJR CO.,LTD.

業務受託会社

(国内) (株)エヌ・ジェイ・アールサービス

グループ会社

佐賀エレクトロニクス(株)
佐賀県神埼郡

THAI NJR CO.,LTD.
タイ国ランブーン市



半導体製造後工程の主力工場



半導体製造後工程担当

グループ会社

(株)エヌ・ジェイ・アール福岡
福岡県福岡市



半導体製造前工程担当

新日本無線株式会社

ご静聴ありがとうございました。

－ 予想数値に関する注意事項 －

この資料に記載されている業績予想数値は、現時点で入手可能な情報をもとにした当社における推測・予測に基づくものであり、確約や保証を与えるものではありません。

実際の業績は、様々な要因により、これらの予想数値とは大きく異なる場合があります。予めご承知の上、ご利用下さいますようお願い申し上げます。